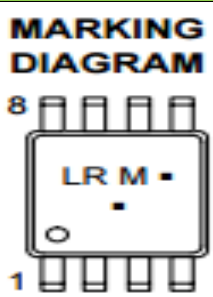
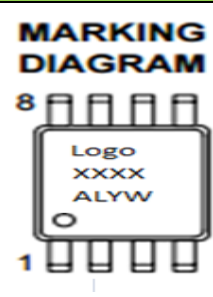




Title of Change:	Interface and Bus Switch Back End Site and Material Change	
Proposed first ship date:	7 February 2019 or earlier upon customer approval	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <logic.fpcn@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Phine.Guevarra@onsemi.com>	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Affected product will be marked with new marking style	
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☒ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☒ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☒ Shipping/Packaging/Marking ☒ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia	External Foundry/Subcon Sites: Subcon Thailand
Description and Purpose:		
Qualify a new subcon site to increase capacity.		
Material to be changed	Before Change (Existing flow)	After Change (new flow)
Assy Site	ON Seremban Malaysia	Subcon Thailand
Mold Compound	MC SUMITOMO EME-G600FB	Molding Compound G600
Lead frame	AG STRIPE OVER D005	LF; PPF+ME2; US8; DAP 59x38
Die Attach	DA EN4370K3 SNAP CURE NON-C	Non-Conductive DAF, HR-5140
Plating	100% Sn	Preplated
Product marking change	 LR =Device Code, M = D ate Code, Dot(.)=Lead Free Package	 XXXX=Device Code, A= Assy location, L= Lot Code,Y=Year Code, W =Week Code

**Reliability Data Summary:****QV DEVICE NAME:** NLV7WBD3125USG**RMS:** S44394**PACKAGE:** US 8

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	1008 hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 15
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30

QV DEVICE NAME: NLV9306USG**RMS:** P44400 ; S48494**PACKAGE:** US 8

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	1008 hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 15
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30

Electrical Characteristic Summary: Electrical characteristics Available upon request.**List of Affected Parts:**

Part Number	Qualification Vehicle
PCA9306USG	NLV9306USG
7WBD3125USG	NLV7WBD3125USG
7WBD383USG	NLV7WBD3125USG
7WBD3306USG	NLV7WBD3125USG
7WBD3126USG	NLV7WBD3125USG
7WBD3305USG	NLV7WBD3125USG

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

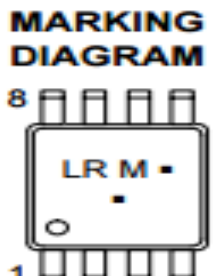
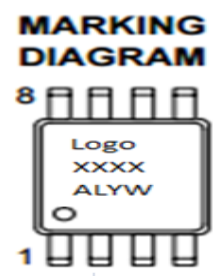
注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号: FPCN22476X

発行日: 31 October 2018

変更件名:	インターフェースとバス スイッチ バック エンド サイトと材料の変更	
初回出荷予定日:	7 February 2019、またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <logic.fpcn@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
その他の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Phine.Guevarra@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> をお願いします。	
変更部品の識別:	影響を受ける製品には新しいマーキング スタイルでマークが付けられます	
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☒ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☒ 材料の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☒ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☒ 出荷/パッケージング/表記 ☒ 製造プロセスの変更 ☐ その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: オン セレンバン(マレーシア)	外部製造工場または下請け業者拠点: サブコン(タイ)
説明および目的: 生産能力を増強するために新しい下請け業者の拠点を認定します。		
変更される材料	変更前 (既存のフロー)	変更後 (新規フロー)
組み立て拠点	オン セレンバン(マレーシア)	サブコン(タイ)
モールド・コンパウンド	MC SUMITOMO EME-G600FB	モールド コンパウンド G600
リードフレーム	AG STRIPE OVER D005	LF、PPF+ME2、US8、DAP 59x38
ダイ接着剤	DA EN4370K3 SNAP CURE NON-C	非導電 DAF、HR-5140
めっき	100% Sn	めっき前処理済み
	変更前	変更後
製品表示変更	 LR = デバイスコード、M = 日付コード、 Dot(.) = 無鉛パッケージ	 XXXX = デバイスコード、A = 組み立て場所、 L = ロットコード、Y = 年コード、W = 週コード



信頼性データの要約:

QV 素子名: NLV7WBD3125USG

RMS: S44394

パッケージ: US 8

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	1008 hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 15
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30

QV 素子名: NLV9306USG

RMS: P44400、S48494

パッケージ: US 8

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	1008 hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 15
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30

電気的特性の要約: 電気的特性の提出は要求に基づきます。

影響を受ける部品の一覧:

部品番号	品質試験用ビークル
PCA9306USG	NLV9306USG
7WBD3125USG	NLV7WBD3125USG
7WBD383USG	NLV7WBD3125USG
7WBD3306USG	NLV7WBD3125USG
7WBD3126USG	NLV7WBD3125USG
7WBD3305USG	NLV7WBD3125USG